

# 研究評価委員会

## 「次世代半導体微細加工・評価基盤技術の開発」(事後評価) 分科会

日時：平成28年6月21日(火) 9:30~18:00

場所：大手町サンスカイルームA室 (朝日生命大手町ビル27階)

### 議事次第

#### 【公開セッション】

- |                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| 1. 開会、資料の確認                           | 9:30~9:35 (5分)    |
| 2. 分科会の設置について                         | 9:35~9:40 (5分)    |
| 3. 分科会の公開について                         | 9:40~9:45 (5分)    |
| 4. 評価の実施方法について                        | 9:45~9:55 (10分)   |
| 5. プロジェクトの概要説明                        |                   |
| 5.1 「事業の位置付け・必要性」「研究開発マネジメント」         | 9:55~10:10 (15分)  |
| NEDO IoT推進部 主査 片岡 茂                   |                   |
| 5.2 「研究開発成果」「成果の実用化・事業化に向けた取り組み及び見通し」 |                   |
| プロジェクトリーダー (株)EUVL基盤開発センター顧問 森 一朗     |                   |
|                                       | 10:10~10:30 (20分) |
| 5.3 質疑応答                              | 10:30~11:00 (30分) |

一般傍聴者退室・休憩 (5分)

#### 【非公開セッション】

- |                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| 6. プロジェクトの詳細説明         | ※ 株式会社EUVL基盤開発センター 各担当部長が説明 |
| 6.1 EUVマスクブランク欠陥検査技術開発 | 11:05~11:35 (30分)           |
|                        | (説明15分、質疑応答15分)             |
| 6.2 EUVマスクパターン欠陥検査技術開発 | 11:35~12:05 (30分)           |
|                        | (説明15分、質疑応答15分)             |

昼食・休憩 (60分)

- |                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| 6.3 EUVレジスト材料技術開発   | (説明各10~15分、質疑応答30分) |
| 6.3-① EUVレジスト材料技術開発 | 13:05~13:20 (15分)   |
| 6.3-② アウトガス測定方法     | 13:20~13:30 (10分)   |
| 6.3-③ DSA技術開発       | 13:30~13:40 (10分)   |
| 質疑応答                | 13:40~14:10 (30分)   |

実施者入替・休憩（5分）

7. 成果の実用化・事業化に向けた取り組み及び見通しについて

- 7.1 EUVマスクブランク欠陥検査装置事業計画 14:15～14:40（25分）  
レーザーテック株式会社（説明10分、質疑応答10分、入替5分）
- 7.2 EUVマスクパターン欠陥検査装置事業計画 14:40～15:00（20分）  
株式会社荏原製作所（説明10分、質疑応答10分）

実施者入替・休憩（15分）

- 7.3 EUVブランク事業計画 15:15～15:40（25分）  
HOYA株式会社（説明10分、質疑応答10分、入替5分）
- 7.4 EUVマスク事業計画 15:40～16:05（25分）  
大日本印刷株式会社（説明10分、質疑応答10分、入替5分）
- 7.5 EUVレジスト事業計画（2社） 16:05～16:55（50分）  
JSR株式会社（説明10分、質疑応答10分、入替5分）  
富士フイルム株式会社（説明10分、質疑応答10分、入替5分）
- 7.6 メモリ事業へのEUVL技術適用計画 16:55～17:15（20分）  
株式会社東芝（説明10分、質疑応答10分）

実施者入室・休憩（5分）

8. 全体を通しての質疑応答 17:20～17:30（10分）

一般傍聴者入室（5分）

**【公開セッション】**

9. まとめ・講評 17:35～17:55（20分）
10. 今後の予定、その他 17:55～18:00（5分）
11. 閉会